

# 設備作業標準

## (SE-031 化學機械研磨系統)

標準作業程序：

1. 刷卡開機。
  2. 按 ENTER ACCESS CODE 鍵輸入機台密碼。
  3. 在 Manual Operations 選項上按 FLUSH FLUID LINES，沖洗待機狀態的機台管路。
  4. 到 Process Management 選項上 LOAD 一個新製程參數。
  5. 把漿料管路放入研磨漿中，然後到 Polish Control 選項上執行合適的 SLURRY TEST，直到漿料流注於研磨墊上。
  6. 在 Phase setup1 選項上設定研磨時間並確認製程參數。
  7. 到 Phase setup2 選項上確認製程參數，同時確定所使用的研磨漿。
  8. 當晶圓放入晶舟後，按 Load Service Switch 鈕使機台 IN-SERVICE。
  9. 按 SPINDLE ON 鈕，再按 START 鈕開始製程，下面的流程將自動執行:載入程序，研磨程序，清洗過程以及晶圓送出。
  10. 研磨結束，按 END 鈕。
  11. 按 Unload Service Switch 鈕將晶圓取出。
  12. 到 Polish Control 選項上按 SLURRY TEST，然後把漿料管路放入純淨的 DI 水中清洗，直至清水流注於研磨墊上。
  13. 在 Manual Operations 選項上按 FLUSH FLUID LINES 進行清洗。
  14. 按 SPINDLE ON 鈕，檢查 Carrier 是否在清洗槽，同時槽中注滿 DI 水。
  15. 檢查 Arm IO 選項上 PSI SELECT 是否燈亮；若否，則按鍵使它亮起。
  16. 檢查轉盤是否轉動並定時噴水濕潤研磨墊。
  17. 按 ENTER ACCESS CODE 鍵輸入任一數字鎖住機台。
  18. 刷卡關機。
-